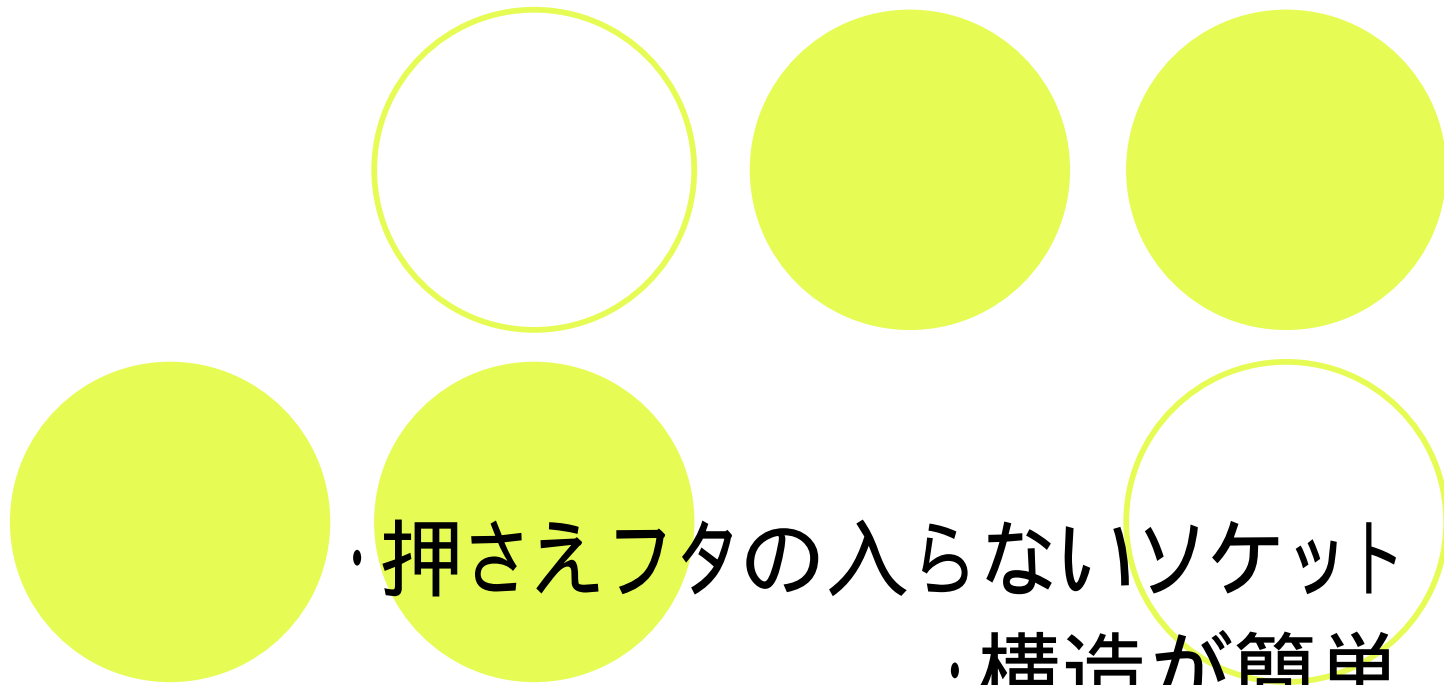


実装用BGAソケット(APROS-Cシリーズ)



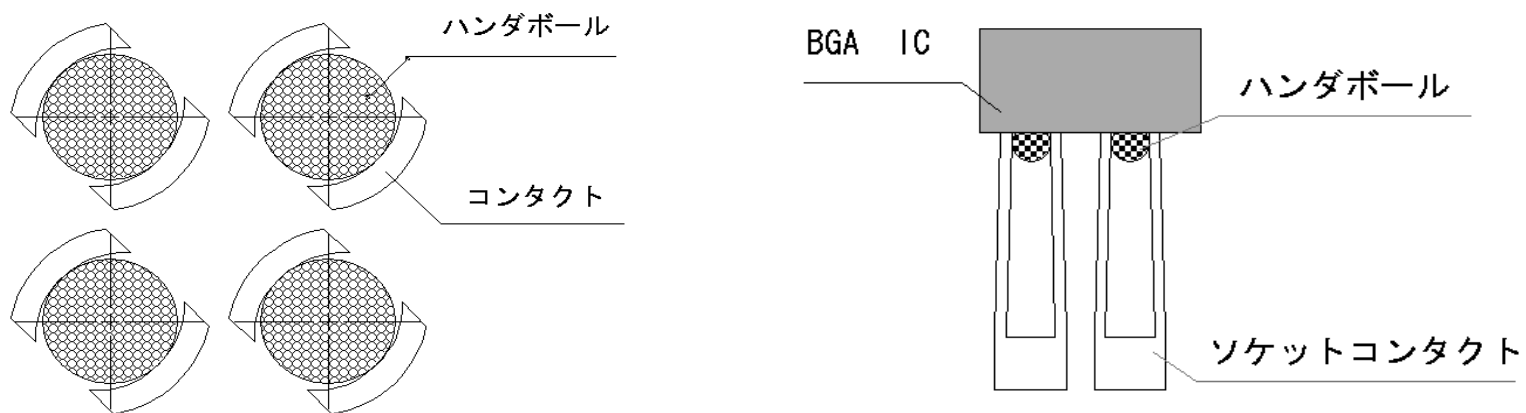
・押さえフタの入らないソケット

・構造が簡単

・実装面積が小さい

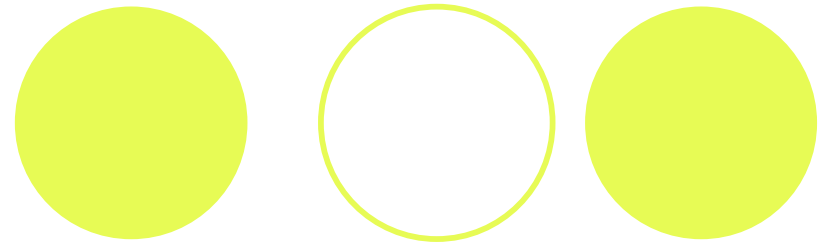
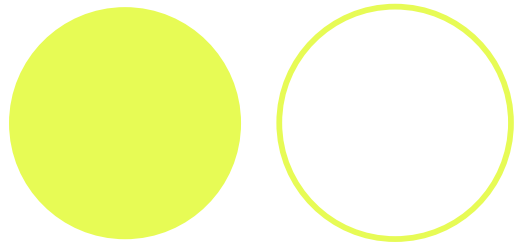
コンタクト構造

BGAソケット コンタクト構造



ハンダボールを2枚のコンタクトで挟み込む

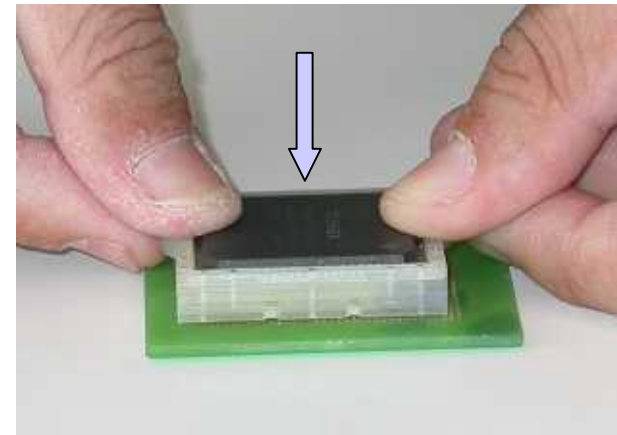
フタの必要のないBGAソケット構造



BGA ICの挿抜が簡単

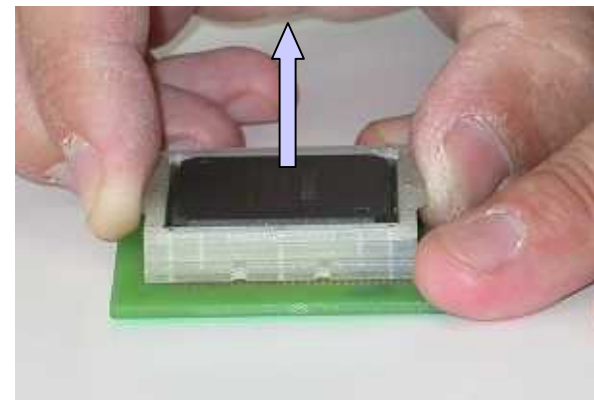
- 挿入

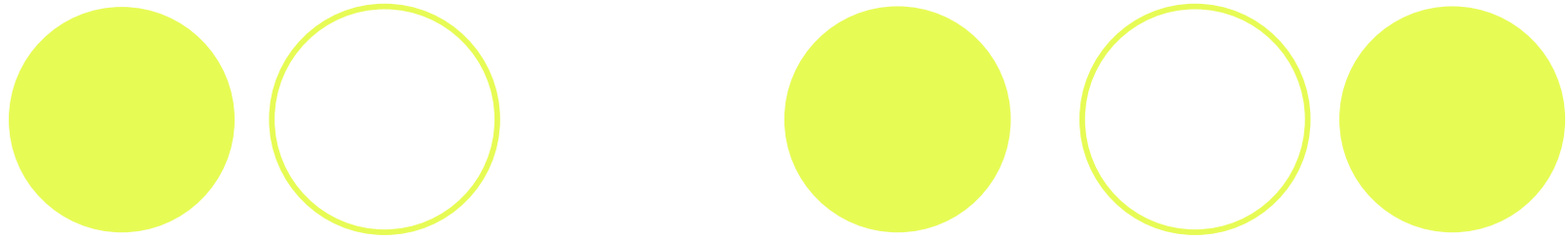
BGA ICをソケットの上から押し込むだけ



- 抜去

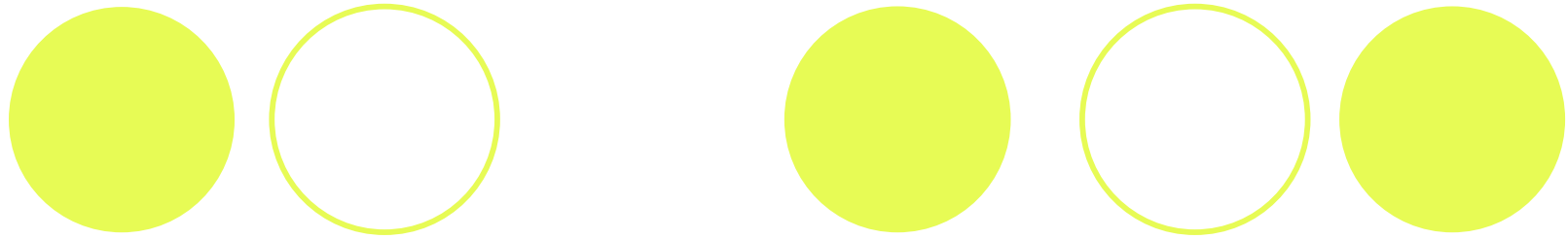
ソケットのフローティングインシュレータの横から指で持ち上げる



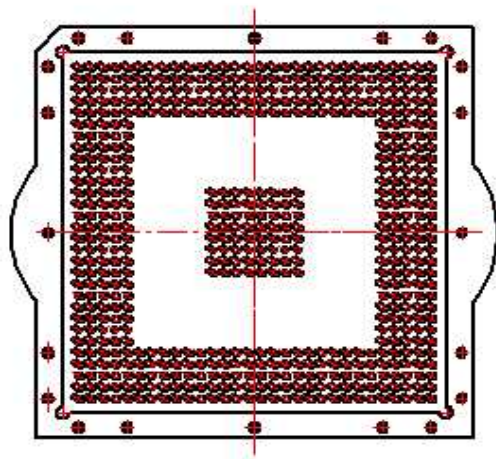


BGAソケットの実装面積が小さい

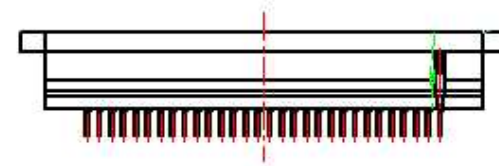
- BGA ICの外形寸法プラス5mm



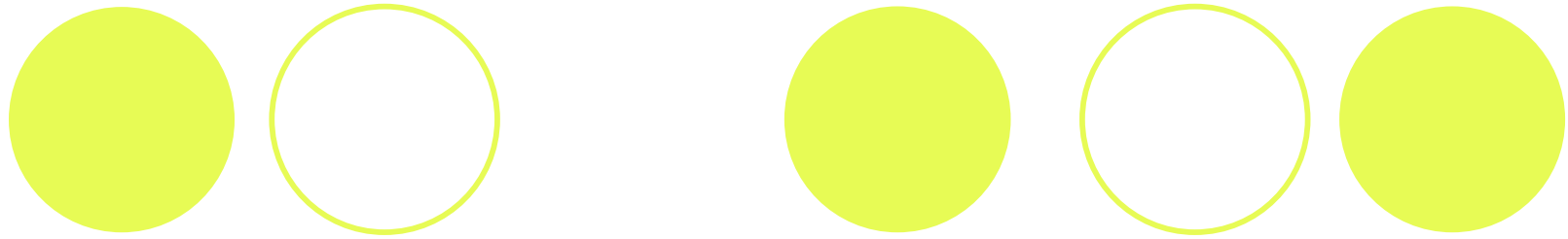
スルーホールタイプ BGAソケットの構造図



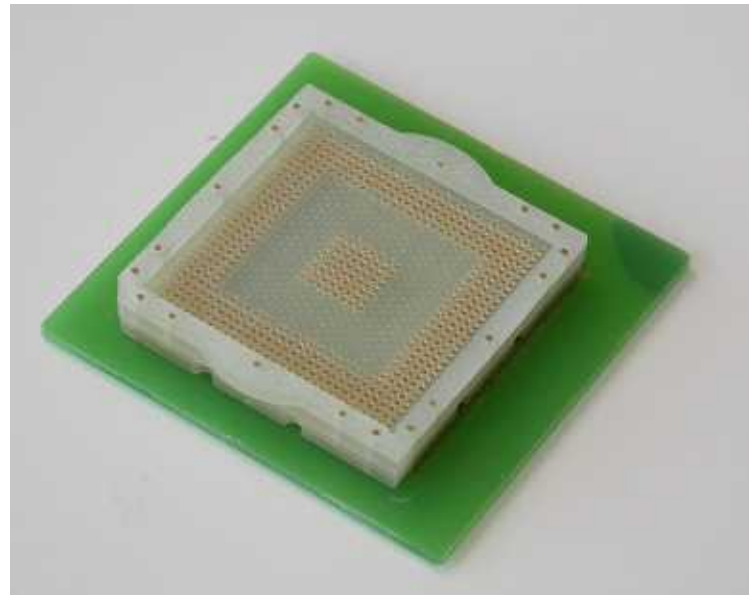
上面図

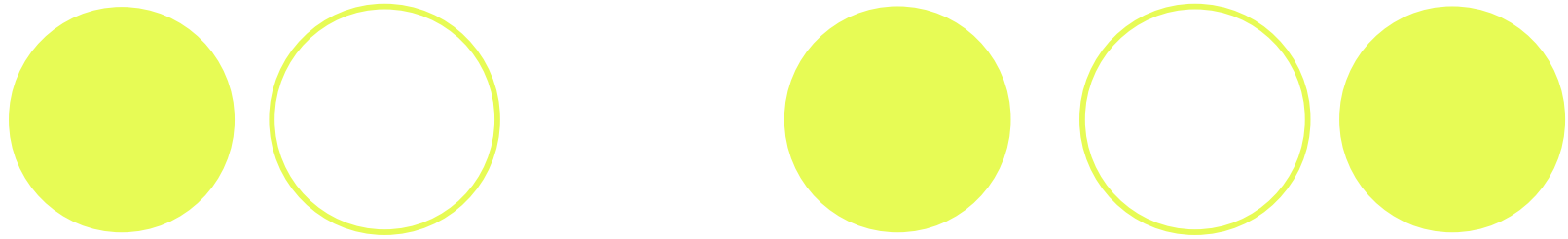


横図



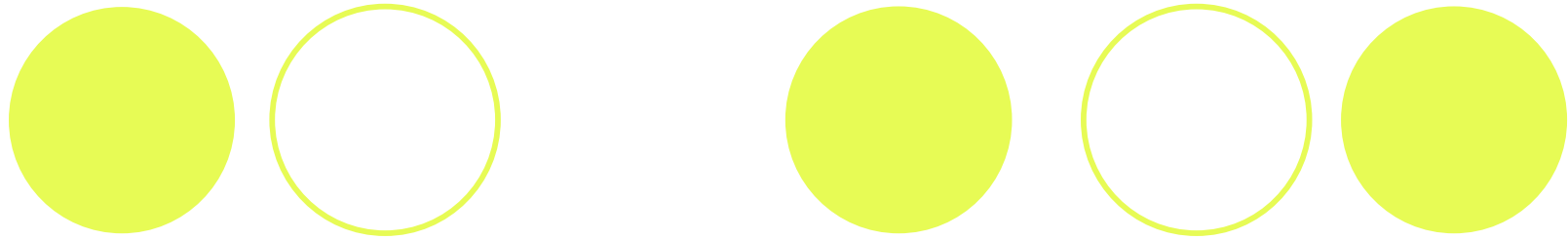
スルーホールタイプ BGAソケットの写真





スルーホールタイプ BGAソケット構成部品

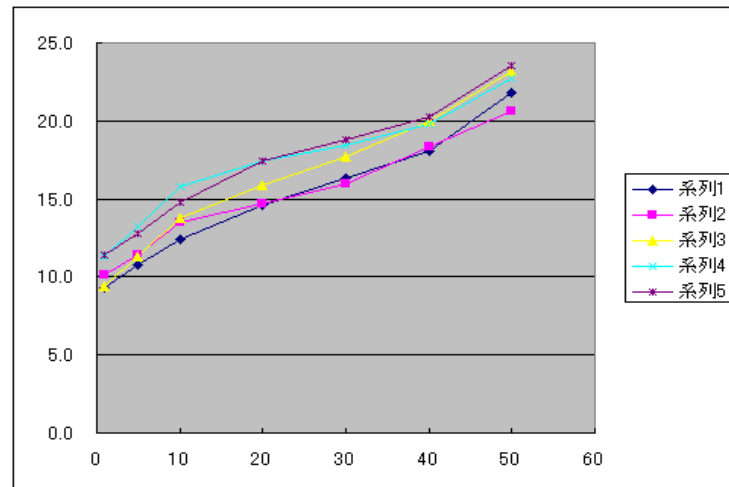
1. ソケットコンタクト
2. ベースインシュレータ
3. フローティングインシュレータ
4. 止めピン

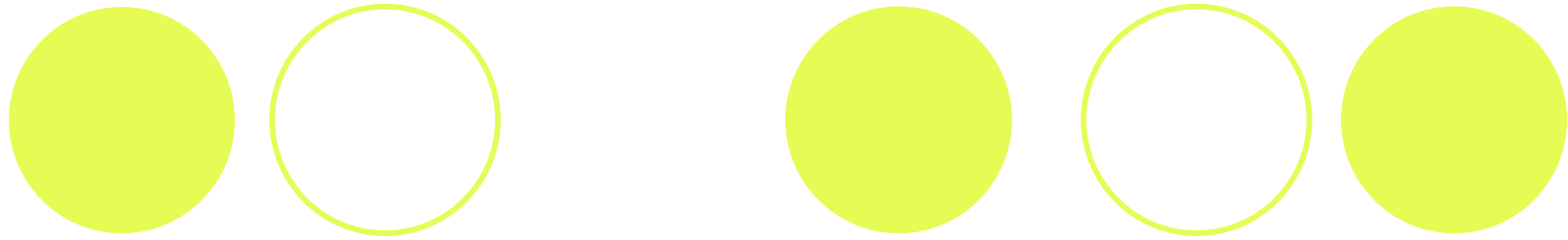


BGAソケット接触抵抗データ

挿抜回数	1	5	10	20	30	40	50
サンプル1 平均値	9.3	10.8	12.4	14.6	16.3	18.1	21.8
サンプル2 平均値	10.1	11.4	13.5	14.7	16.0	18.3	20.6
サンプル3 平均値	9.4	11.3	13.8	15.9	17.7	20.0	23.2
サンプル4 平均値	11.3	13.2	15.8	17.4	18.4	19.8	22.7
サンプル5 平均値	11.4	12.8	14.8	17.4	18.8	20.3	23.5

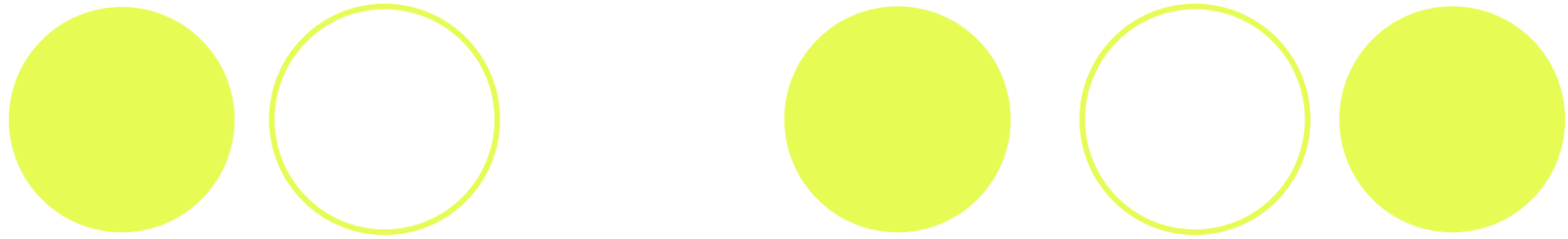
単位: mΩ





他社 B G A ソケットとの比較

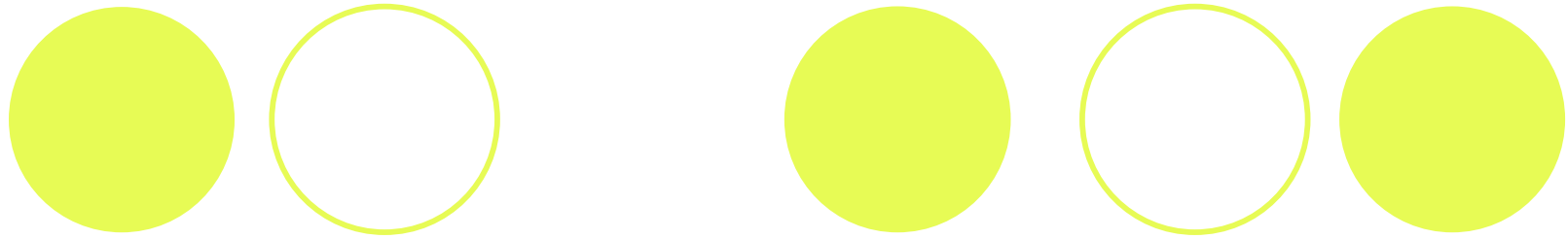
	パーインソケット	プローブ使用ソケット	弊社ソケット
用途	量産ICの生産工程テスト	ICの開発, 評価用	ICの開発, 評価用
フットパターン	DIP変換	BGA ICと同じ	BGA ICと同じ
ターゲット基板	ソケット用に作製	フタがネジ止めタイプが多くネジ止め用の穴が必要	量産基板とほぼ同じ
実装面積	大	大	BGA ICとほぼ同じ
価格	◎ (特注品は高い)	×	○



適合BGA IC

- 1.27mmピッチ BGA
 - 1.0mmピッチ BGA

各ピッチ600ピンまで対応



仕様概要

- 接触抵抗: Max. 100m
- 挿抜寿命: 50回
- 使用温度範囲: -25 ~ +85
- 定格電流: 0.3A / ピン
- 定格電圧: AC, DC 60V